股票代码:688521.SH 股票简称:芯原股份 上市地点:上海证券交易所

芯原微电子(上海)股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)

交易事项	交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产	芯来共创(上海)管理咨询中心(有限合伙)、胡振波、芯来合创(上海)管理咨询中心(有限合伙)等31名交易对方
募集配套资金	不超过35名符合条件的特定对象

签署日期:二〇二五年九月

声明

一、公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证为本次交易所提供的资料和信息是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司持股5%以上股东及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺:如本次交易因涉嫌所披露或提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本企业不转让本人/本企业在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人/本企业向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息的,授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过审计机构的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证,也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准、上海证券交易所的审核通过、中国证监会的注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后,本公司经营与收益变化由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时,除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函,将及时提供和披露有关本次交易的资料和信息,并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如交易对方提供的关于本次交易的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,交易对方将依法承担相应的法律责任。

如本次交易因涉嫌所披露或提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本人/本企业向上海证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向上海证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向上海证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息的,授权上海证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

释义

在本预案摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、一般名词释义		
预案/摘要/本预案/本预案摘要	指	《芯原微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)》
预案/重组预案	指	《芯原微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
重组报告书/草案	指	本次交易审计、评估等相关工作完成后,就本次交易编制的重组报告书
芯原股份/公司/本公司/上市公司/芯原	指	芯原微电子(上海)股份有限公司
本次交易/本次重组/本次发行	指	上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得芯来科技97.0070%股权,并募集配套资金
香港富策	指	富策控股有限公司
国家集成电路产业投资基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
嘉兴时兴	指	嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:共青城时兴投资合伙企业(有限合伙))
共青城文兴	指	共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴海橙	指	嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)
国开科创	指	济南国开科创产业股权投资合伙企业(有限合伙)
标的公司/交易标的/芯来科技	指	芯来智融半导体科技(上海)有限公司
标的资产/拟购买资产	指	芯来智融半导体科技(上海)有限公司97.0070%股权
芯来共创	指	芯来共创(上海)管理咨询中心(有限合伙)
芯来合创	指	芯来合创(上海)管理咨询中心(有限合伙)
上海新仲	指	上海新仲投资中心(有限合伙)
小米产投	指	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)
上海君联	指	上海君联晟源创业投资合伙企业(有限合伙)
中电科	指	中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)
嘉兴科微	指	嘉兴科微创业投资合伙企业(有限合伙)
北京君联	指	北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)
元之芯	指	苏州元之芯创业投资合伙企业(有限合伙)
水木清心	指	北京水木清心创业投资中心(有限合伙)
橙叶投资	指	橙叶芯扬(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)
中关村芯创	指	北京中关村芯创集成电路设计产业投资基金(有限合伙)
西安君联	指	西安君联南盈股权投资合伙企业(有限合伙)
晶毅商务	指	上海晶毅商务咨询合伙企业(有限合伙)
厦门建发	指	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)
临颜创投	指	扬州临颜创业投资合伙企业(有限合伙)
擎宇投资	指	杭州擎宇股权投资基金合伙企业(有限合伙)
上海科创	指	上海科创中心贰号私募投资基金合伙企业(有限合伙)
烽火投资	指	武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)
临创志芯	指	无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)
启明投资	指	扬州启明股权投资合伙企业(有限合伙)
天堂硅谷	指	武汉天堂硅谷恒新创业投资基金合伙企业(有限合伙)
首大兴业	指	北京首大兴业股权投资中心(有限合伙)
中芯熙诚	指	中芯熙诚(北京)数字科技基金(有限合伙)
十月投资	指	福建晋江十月乾元股权投资合伙企业(有限合伙)
启熔创投	指	深圳启熔天使创业投资企业(有限合伙)
杭州精确	指	杭州精确未来股权投资合伙企业(有限合伙)
厦门精确	指	厦门精确蓝海三朝创业投资合伙企业(有限合伙)
瑞知创投	指	南宁市瑞知创业投资有限公司
乾益投资	指	扬州乾益投资合伙企业(有限合伙)
交易对方	指	芯来共创、胡振波、芯来合创、上海新仲、小米产投、上海君联、中电科、嘉兴科微、北京君联、元之芯、水木清心、橙叶投资、中关村芯创、西安君联、晶毅商务、厦门建发、临颜创投、擎宇投资、上海科创、烽火投资、临创志芯、启明投资、天堂硅谷、首大兴业、中芯熙诚、十月投资、启熔创投、杭州精确、厦门精确、瑞知创投、乾益投资
各方/交易各方	指	上市公司、交易对方、标的公司
双方/交易双方	指	上市公司、交易对方
定价基准日	指	上市公司第三届董事会第三次会议决议公告日
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法(2025年修正)》
《监管指引第7号》	指	《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2025年修正)》
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2025年修正)》
GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中登公司/登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、专业名词或术语释义		
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
RISC-V	指	一种基于精简指令集原则的开放指令集架构
EDA/EDA工具	指	Electronic Design Automation,即电子设计自动化软件工具
IP、半导体IP	指	Semiconductor Intellectual Property,是已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块。该电路模块设计可以应用在包含该电路模块的其他芯片设计项目中,从而减少设计工作量,缩短设计周期,提高芯片设计的成功率
集成电路、芯片	指	是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件
晶圆	指	又称Wafer,圆片,晶片,用以制造集成电路的圆形硅晶体半导体材料
工艺节点、制程	指	集成电路内电路与电路之间的距离,精度越高,同等功能的IC体积越小、成本越低、功耗越小,当前工艺节点已达nm级
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功,需要进行流片,即从一个电路图到一块芯片,检验每一个工艺步骤是否可行,检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功,就可以大规模地制造芯片;反之,则需找出其中的原因,并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程试作样片流片。在工程试作样片流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
IDM	指	Integrated Device Manufacturer,指涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
系统厂商	指	面向终端应用提供整机系统设备的厂商,本报告中系统厂商包括OEM和ODM
芯片设计公司	指	无晶圆生产设计公司,指企业只从事集成电路研发和销售,而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
IPnest	指	知名IP领域调研机构
SHD Group	指	知名半导体和人工智能领域的咨询公司
ARM	指	ARM Limited,知名芯片架构设计公司及半导体IP提供商,其创立的ARM架构是一种基于精简指令集(RISC)设计的处理器架构
CPU	指	Central Processing Unit,即中央处理器,是一台计算机的运算和控制核心,其功能主要是完成对计算机指令的执行和对数据的处理
处理器IP	指	用于完成取指令、执行指令、以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作的数字IP
GPU IP	指	图形处理器IP,专用于绘图运算工作的数字IP
NPU IP	指	神经网络处理器IP,专用于加速神经网络运算、机器视觉和机器学习等人工智能应用的数字IP
VPU IP	指	视频处理器IP,专用于进行视频编解码,并结合视频增强处理和压缩技术的数字IP
DSP IP	指	数字信号处理器IP,专用于将数字信号进行高速实时处理的数字IP
ISP IP	指	图像信号处理器IP,专用于对图像传感器的原始数据进行处理以获得优质视觉图像的数字IP
Display Processing IP	指	显示处理器IP,是一种进行图像显示处理的数字IP
射频IP	指	射频IP指用于处理由天线发送接收的一定频率射频信号的IP
SoC、系统级芯片	指	Systemon Chip,即片上系统,是将系统关键部件集成在一块芯片上,可以实现完整系统功能的芯片电路
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit,一种为专门目的而设计的集成电路,是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
版图	指	Integrated Circuit Layout,集成电路版图,是真实集成电路物理情况的平面几何形状描述

注:(1)本预案摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;(2)本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果等将在本次交易的重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可能与本预案摘要相关数据存在一定差异,特请投资者注意。

本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。提醒投资者认真阅读本预案摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概况

(一)本次重组方案概况

本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向芯来共创、胡振波、芯来合创等31名交易对方购买其合计持有的芯来科技97.0070%股权,并募集配套资金。截至本预案摘要签署日,上市公司直接持有芯来科技2.9930%股权,本次交易完成后,芯来科技将成为上市公司的全资子公司。

芯原是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司于2020年上市,被誉为“中国半导体IP第一股”,随着公司业务在业界获得更广泛的关注和更深的认知,目前公司已被业界誉为“AI ASIC龙头企业”。此次交易将完善芯原核心处理器IP+CPU IP的全栈式异构计算版图,同时也将强化公司AI ASIC的设计灵活度和创新能力,提升公司关键业务的市场竞争力。

目前,芯原拥有用于各类异构计算的六大类关键处理器IP,分别为图形处理器IP(GPU IP)、神经网络处理器IP(NPU IP)、视频处理器IP(VPU IP)、数字信号处理器IP(DSP IP)、图像信号处理器IP(ISP IP)和显示处理器IP(Display Processing IP),以及1,600多个数模混合IP和射频IP。根据IPnest统计,2024年,芯原的半导体IP授权业务市场占有率位列中国第一,全球第八;知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据各类公开信息,芯原IP种类在全球排名前十的IP企业中排名前二。其中,芯原的GPU已有20多年发展历史,目前在数据中心、汽车电子、可穿戴设备、PC等领域出货已超过20亿颗;芯原全球领先的NPU IP已在91家客户的140多款芯片中获得采用,覆盖了服务器、汽车、智能手机、可穿戴设备等10余个市场领域,相关芯片出货已近2亿颗;公司的VPU IP则已被全球前20大云平台解决方案提供商中的12家,中国前5大互联网提供商中的3家,以及2024年中国造车新势力排名前8家中的5家所采用。

在AI ASIC领域,芯原基于自有的丰富IP和领先的芯片定制能力,已推出面向广泛AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案,涵盖如智能手表、AR/VR眼镜等始终在线的轻量化空间计算设备,AI PC、AI手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备,以及数据中心、服务器等高性能云侧计算设备,且端侧、云侧AI ASIC均有众多客户项目已经或正在逐步量产上市。芯原股份2025年上半年芯片设计业务收入中,AI算力相关收入占比约52%。

芯来科技成立于2018年,是中国本土首批RISC-V CPU IP提供商之一,目前拥有员工100余人,已累计开发数十款IP产品。芯来科技从零开始,坚持自研,打造了全系列RISC-V CPU IP矩阵和领先的车规IP产品,自研了全栈的SoC IP矩阵和子系统IP平台。近年来,芯来科技的RISC-V IP业务在中国本土处于领先地位,已成为全球RISC-V IP赛道第一梯队的代表性企业之一。芯来科技在全球已授权客户超300家,产品广泛应用于AI、汽车电子、工业控制、5G通信、物联网、网络安全、存储和MCU等多个领域。2023年7月,芯来科技成为全球首家通过ISO 26262 ASIL-D级别汽车功能安全认证的RISC-V CPU IP公司。2024年,其CPU IP业务收入在中国RISC-V IP企业中位居前列。

芯原以推动RISC-V生态发展为切入点,已积极布局RISC-V行业超过七年。2018年7月上海市经信委发布国内首个和RISC-V相关的支持政策。2018年9月,由上海集成电路行业协会推荐芯原作为首任理事长单位牵头成立了中国RISC-V产业联盟(CRVIC),芯来科技为第一批加入联盟的企业。截至2025年6月底,会员单位已达到204家。2024年9月,芯原股份联合芯来科技、达摩院(上海)共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心(SOPIC),该中心专注于推动处理器技术,特别是基于开放指令集架构(如RISC-V)的研发、生态建设和产业化应用。

由中国RISC-V产业联盟和芯原股份共同主办的滴水湖中国RISC-V产业论坛已经成功召开了4届,每届会议集中发布10余款来自不同本土企业的国产RISC-V芯片新品,现已累计推广了40多款。2025年7月16-19日,芯原股份协助上海开放处理器产业创新中心在上海举办第五届“RISC-V中国峰会”,包括1场主论坛、9场垂直领域分论坛、5场研习会、11项同期活动,以及4500平方米未来科技展览区,汇聚来自17个国家的数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。主论坛当日共计3000余人线下参会,12.5万人次线上观看论坛直播;当日媒体原创报道达200余篇,会后媒体原创报道总数达425篇。参会总人数为8188人,总人次超过万人。

目前,芯原已与业内多家RISC-V领先企业达成合作。截至2025年6月末,公司的半导体IP已经获得RISC-V主要芯片供应商的10余款芯片所采用,并为20家客户的23款RISC-V芯片提供了一站式芯片定制服务,上述项目正陆续进入量产。同时,芯原还基于RISC-V核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感SoC等多个芯片设计平台,以及基于RISC-V核的硬件开发板,上述解决方案正逐步获得客户采用,有力地推动了RISC-V技术的商业化进程。

随着RISC-V生态的逐步成熟,以及公司RISC-V相关业务快速发展的需要,公司将通过本次交易,进一步强化在RISC-V领域的布局。芯原已拥有针对异构计算的丰富的处理器IP储备,交易将为公司补足优质且具有高速发展前景和广阔应用空间的CPU IP,从而构建全栈式异构计算IP平台,进一步提升公司的竞争力、拓展与现有客户的合作深度、提高客户粘性,以及扩大业务发展空间。此外,RISC-V凭借其模块化指令集与可扩展性,为AI计算提供了显著的技术优势。本次交易使芯原能够在为客户定制AI ASIC时,灵活采用通用RISC-V CPU、定制化指令扩展及微架构创新,打造更具差异化和市场竞争力的芯片解决方案。公司还可依托RISC-V开放生态,高效利用现有技术成果,为不同AI应用场景构建更灵活的软硬件设计平台。上述成果将为公司的AI ASIC业务带来更高的效益与产业价值,进一步推动AI ASIC和RISC-V技术的协同发展与产业化。

综上所述,本次交易完成后,上市公司将能够利用自身半导体IP和芯片定制平台的技术赋能能力,通过协同芯来科技在RISC-V领域的技术资源,加速推进RISC-V的规模化落地,进一步提升上市公司的市场影响力和技术壁垒,为上市公司股东创造长期价值。本次交易将通过构建开放的RISC-V硬件平台、打造开源的RISC-V软件生态,推动RISC-V生态体系在中国的快速发展。

本次重组方案具体如下:

交易形式		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
交易方案简介		上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买芯来共创、胡振波、芯来合创等31名交易对方合计持有的芯来科技97.0070%股权。同时,上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。	
交易价格		截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。	
交易标的	名称	芯来科技97.0070%股权	
	主营业务	提供集成电路产品所需的半导体IP设计、授权及相关服务	
	所属行业	根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”	
	其他	符合板块定位	√是 □否 □不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 □否
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否
交易性质		构成关联交易	□是(预计)√否
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	√是(预计)□否
		构成重组上市	□是 √否
本次交易有无业绩补偿承诺		截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否提供业绩补偿承诺安排	
本次交易有无减值补偿承诺		截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否提供减值补偿承诺安排	
其他需特别说明的事项		无	

(二)标的资产评估作价情况

标的资产	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
芯来科技97.0070%股权	截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。						

(三)本次重组支付方式

序号	交易对方	持有标的公司权益比例	支付方式			向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	其他	
1	芯来共创	15.7389%	尚未确定	尚未确定	无	标的资产最终交易价格尚未确定
2	胡振波	14.9652%	尚未确定	尚未确定	无	
3	芯来合创	11.7944%	尚未确定	尚未确定	无	
4	上海新仲	7.7029%	尚未确定	尚未确定	无	
5	小米产投	6.1194%	尚未确定	尚未确定	无	
6	上海君联	5.2557%	尚未确定	尚未确定	无	
7	中电科	3.0557%	尚未确定	尚未确定	无	
8	嘉兴科微	2.7594%	尚未确定	尚未确定	无	
9	北京君联	2.6278%	尚未确定	尚未确定	无	
10	元之芯	2.3125%	尚未确定	尚未确定	无	
11	水木清心	2.1552%	尚未确定	尚未确定	无	
12	橙叶投资	2.1016%	尚未确定	尚未确定	无	
13	中关村芯创	1.9916%	尚未确定	尚未确定	无	
14	西安君联	1.9415%	尚未确定	尚未确定	无	
15	晶毅商务	1.7459%	尚未确定	尚未确定	无	
16	厦门建发	1.4562%	尚未确定	尚未确定	无	
17	擎宇投资	1.4562%	尚未确定	尚未确定	无	
18	临颜创投	1.4562%	尚未确定	尚未确定	无	
19	上海科创	1.4561%	尚未确定	尚未确定	无	
20	烽火投资	1.1358%	尚未确定	尚未确定	无	
21	临创志芯	1.0842%	尚未确定	尚未确定	无	
22	启明投资	0.9747%	尚未确定	尚未确定	无	
23	天堂硅谷	0.9708%	尚未确定	尚未确定	无	
24	首大兴业	0.9708%	尚未确定	尚未确定	无	
25	中芯熙诚	0.7797%	尚未确定	尚未确定	无	
26	十月资本	0.7797%	尚未确定	尚未确定	无	
27	启熔创投	0.6684%	尚未确定	尚未确定	无	
28	杭州精确	0.6067%	尚未确定	尚未确定	无	
29	厦门精确	0.4854%	尚未确定	尚未确定	无	
30	瑞知创投	0.4368%	尚未确定	尚未确定	无	
31	乾益投资	0.0216%	尚未确定	尚未确定	无	

(四)股份发行情况

股票种类	境内人民币普通股(A股)		每股面值	1.00元
定价基准日	上市公司第三届董事会第三次会议决议公告日		发行价格	106.66元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
发行数量	本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量=向各交易对方发行股份的数量之和,其中向各交易对方发行股份数量=以发行股份方式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。向交易对方发行的股份数量向下取整精确至股,不足一股的部分相应计入上市公司的资本公积金。 鉴于标的资产的交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定,具体发行数量将在重组报告书中予以披露,并最终以上市公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。 在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。			
是否设置发行价格调整方案	√是 □否			
锁定期安排	交易对方通过本次交易取得的上市公司新增发行的股份,自新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起12个月内不得上市交易或转让;但是,若交易对方取得新增股份时,交易对方对用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起36个月内不得上市交易或转让。若交易对方属于私募投资基金且于上市公司关于本次交易的首次董事会决议公告时交易对方对用于认购新增股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满48个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起6个月内不得上市交易或转让。 本次交易实施完毕后,交易对方所持新增股份由于上市公司派息、送股、转增股本或配股等原因而增加的,该等增加的股份亦应遵守上述股份限售安排。 如前述关于新增股份的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关监管意见进行相应调整。			

二、募集配套资金情况

(一)募集配套资金概况

募集配套资金金额	募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%,最终发行数量以经中国证监会同意注册的发行数量为准。
发行方式	向特定对象发行
发行对象	不超过35名符合条件的特定对象
募集配套资金用途	本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、交易税费、补充上市公司及标的公司流动资金等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

(二)募集配套资金的具体情况

股票种类	境内人民币普通股(A股)		每股面值	1.00元
定价基准日	本次募集配套资金的发行期首日		发行价格	不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由上市公司董事会根据股东会的授权,按照相关法律、法规的规定,依据发行对象申报报价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据市场询价的情况协商确定。 在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。
发行数量	本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。 本次募集配套资金发行股份数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不是一股,则尾数舍去取整,最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。 在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,则本次募集配套资金的股份发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。			
是否设置发行价格调整方案	□是 √否(在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整)			
锁定期安排	本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本、配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构(包括但不限于中国证监会和上交所)的最新监管意见不相符的,将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。			

三、本次交易对上市公司的影响

(一)本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前,上市公司主要从事半导体IP授权服务及一站式芯片定制服务。芯原拥有自主可控的图形处理器IP(GPU IP)、神经网络处理器IP(NPU IP)、视频处理器IP(VPU IP)、数字信号处理器IP(DSP IP)、图像信号处理器IP(ISP IP)和显示处理器IP(Display Processing IP)这六类处理器IP,以及1,600多个数模混合IP和射频IP;在先进半导体工艺节点方面,公司拥有14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验,目前已实现5nm系统级芯片一次流片成功,多个5nm/4nm一站式服务项目正在执行。标的公司主要从事RISC-V半导体CPU IP授权及相关服务。两家公司的业务具有较强的协同效应:首先,上市公司与标的公司均拥有IP授权业务;其次,上市公司的芯片定制业务中,如AI ASIC等异构计算芯片定制业务呈快速增长态势,对自有的处理器IP和标的公司的CPU IP均有较大需求。因此,双方在产品矩阵、客户资源、技术架构与生态建设、降低研发成本等多方面均有协同效应。

公司于2020年上市时,被誉为“中国半导体IP第一股”,随着公司业务在业界获得更广泛的关注和更深的认知,目前公司已被业界誉为“AI ASIC龙头企业”。此次交易将完善芯原核心处理器IP+CPU IP的全栈式异构计算版图,同时也将强化公司AI ASIC的设计灵活度和创新能力,提升公司关键业务的市场竞争力。根据IPnest统计,2024年,芯原的半导体IP授权业务市场占有率位列中国第一,全球第八;知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据各类公开信息,芯原IP种类在全球排名前十的IP企业中排名前二。在AI ASIC领域,芯原基于自有的丰富IP和领先的芯片定制能力,已推出面向广泛AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案,涵盖如智能手表、AR/VR眼镜等始终在线的轻量化空间计算设备,AI PC、AI手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备,以及数据中心、服务器等高性能云侧计算设备,且端侧、云侧AI ASIC均有众多客户项目已经或正在逐步量产上市。芯原股份2025年上半年芯片设计业务收入中,AI算力相关收入占比约52%。

芯来科技成立于2018年,是中国本土首批RISC-V CPU IP提供商之一,目前拥有员工100余人,已累计开发数十款IP产品。芯来科技从零开始,坚持自研,打造了全系列RISC-V CPU IP矩阵和领先的车规IP产品,自研了全栈的SoC IP矩阵和子系统IP平台。近年来,芯来科技的RISC-V IP业务在中国本土处于领先地位,已成为全球RISC-V IP赛道第一梯队的代表性企业之一。芯来科技在全球已授权客户超300家,产品广泛应用于AI、汽车电子、工业控制、5G通信、物联网、网络安全、存储和MCU等多个领域。2023年7月,芯来科技成为全球首家通过ISO 26262 ASIL-D级别汽车功能安全认证的RISC-V CPU IP公司。2024年,其CPU IP业务收入在中国RISC-V IP企业中位居前列。

芯原以推动RISC-V生态发展为切入点,已积极布局RISC-V行业超过七年。2018年7月上海市经信委发布国内首个和RISC-V相关的支持政策。2018年9月,由上海集成电路行业协会推荐芯原作为首任理事长单位牵头成立了中国RISC-V产业联盟(CRVIC),芯来科技为第一批加入联盟的企业。截至2025年6月底,会员单位已达到204家。2024年9月,芯原股份联合芯来科技、达摩院(上海)共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心(SOPIC),该中心专注于推动处理器技术,特别是基于开放指令集架构(如RISC-V)的研发、生态建设和产业化应用。

由中国RISC-V产业联盟和芯原股份共同主办的滴水湖中国RISC-V产业论坛已